



海崇达收入 8.0 亿元，利润 1.34 亿元，珠海崇达在 49 寸大拼板技术方面取得全面突破，在先进智能制造等方面达到行业领先水平，珠海二厂也将复制珠海一厂的工艺路径，快速实现新工厂的盈利。

### 3、公司 2023 年和 2024 年第一季度存货减值较大的原因？

公司在 2023 年及 2024 年一季度计提减值较多，主要是市场竞争加剧，手机、通讯类产品单位售价下降较多，对利润有较大的影响，同时由于库存较多，根据会计准则对存货采用成本与可变现净值孰低计价，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，每季度末均须按会计准则处理，以真实反映财务状况。

针对本次资产减值事项，公司将实施以下举措：

(1) 随着 2024 年通讯和手机市场的库存、需求、价格的改善，将降低公司后续相关产品的存货减值风险，同时公司将积极与客户沟通，促进双方合作共赢；

(2) 公司将继续推动集团“提效率、升品质、降成本”工作，提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，继续改善盈利能力。谢谢！

### 4、公司拟海外投资 10 亿，是怎么考虑的？是否有订单支持？是否要进行再融资？

2023 年度，公司海外销售收入占比 57%，且销售毛利率高于国内市场，在 2023 年度行业景气度大幅下滑的背景下，海外销售毛利率同比上升了 2.37 个百分点。公司在海外市场具有较强的产品、成本和价格竞争力，公司为积极开拓海外订单，保持公司在海外领域的长期竞争优势，同时响应现有海外客户需求，拟投资不超过 10 亿元，通过并购或自建厂房等方式尽快完成海外投资，完善产品在全球市场的供应能力。

公司 2023 年度经营活动现金净额为 11.86 亿元；2023 年期末，公司货币资金为 10.56 亿元，交易性金融资产（公司购买的银行保本浮动收益型理财产品-结构性存款）23.51 亿元，公司经营性现金流良好，本次投资不会影响公司正常经营业务开展和资金使用。

### 5、公司在手订单情况如何？

根据 Prismark 报告，随着去库存进展持续，2024 年市场需求预计将得到一定程度的复苏，2024 年全球 PCB 市场产值为 730 亿美元，同比增长 5%。

受行业周期性波动影响，目前面向通讯、服务器的高多层板，以及子公司的 IC 载板等市场需求和价格持续在恢复。公司具有较强的产品、成本和价格竞争力，2024 年公司将继续推动国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的大客户销售策略，加

大海外订单的导入，加强销售团队建设，为快速填满新开工厂产能做好准备。

#### **6、公司目前覆铜板等原材料价格情况怎样？**

公司主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片和氰化金钾等，受铜、石油和黄金的价格影响较大，覆铜板和贵金属等部分主材和辅材价格有所上升。

公司通过对单位工段成本管控、加大拼板面积提升材料利用率、部分产品结构性提价等系列措施来提升人均产值、人均效益，降低产品单位成本，以消化和转移上游原材料成本上涨带来的影响。

#### **7、汇率变动对公司财务费用影响较大，公司管理汇率风险的模式如何？未来是否会做汇率的套期保值？**

公司外销收入主要采用美元结算，故因美元汇率波动较大导致汇兑损益产生较大波动。2023 年度，公司财务费用同比增加 4,607 万元，主要是汇率波动导致 2023 年度汇兑收益减少 5,777 万元。因无法对汇率波动的方向做出明确的预期，根据公司资金管理办法，公司除有部分美元借款以实现对冲汇率波动的影响外，目前未主动采取相应外汇管理措施应对外汇波动，外汇管理政策相对稳健。

关于套期保值方面，公司目前主要是通过美元直接支付原材料采购款、使用美元采购进口设备、积极开拓国内市场等措施应对汇率的变化，随行就市，汇率的走向受多种复杂因素的影响，难以预估，公司不刻意追求趋势变化的财务投资收益。

#### **8、公司崇达转 2 的转股价格是否会向下修正？**

公司综合考虑自身基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，因此决定暂不向下修正转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 8 月 24 日重新起算，若再次触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“崇达转 2”转股价格的向下修正权利。请关注公司后续发布的相关公告。

#### **9、发展人工智能是未来发展的大趋势，AI 服务器及 GPU 等相关的 PC 应用产品市场也会大幅增长，公司目前相关市场布局和研发情况如何？**

公司在服务器行业接单额增速较快。公司目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理

器, Graphics Processing Unit) 等产品。Whitley 平台已批量发货, 目前正在配合客户进行新一代 Eagle Stream 平台以及其他 AI 服务器 PCB 产品的小批量试制。公司的子公司深圳崇达长期致力于生产服务器品质所需的高可靠性、高稳定性、高容错能力等高速板、高多层板等, 具备大批量生产能力。随着珠海崇达二厂将于 2024 年第二季度投产, 将新增高多层板产能应用于通讯、服务器领域。

公司持续加大服务器领域的研发投入, 2023 年 11 月 23 日, 广东省高新技术企业协会官网公示了《2023 年广东省名优高新技术产品名单》, 公司的“服务器用高多层印制电路板”产品, 凭借科技创新能力突出、技术先进、质量可靠、对产业发展的高价值影响等综合优势, 成功获评为“2023 年度广东省名优高新技术产品”。

#### **10、汽车电子目前客户导入情况如何? 汽车电子订单预期怎样?**

汽车电子方面, 公司目前主要有松下 (Panasonic)、普瑞均胜、泰科电子 (TE Connectivity)、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳 (LG Magna) 等客户, 产品主要应用在电子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。

公司在品质、交期、成本等方面具有较强的综合竞争优势, 公司将持续为客户创造价值。根据与客户的沟通及自身汽车电子产能释放进度, 预计 2024 年汽车电子订单能有较快增长。

#### **11、子公司普诺威的先进封装基板进展如何?**

**关于新产能:** 控股子公司普诺威专注于 BT 载板产品的研发生产, 在深耕 MEMS 类载板市场的基础上, 依靠多年累积的客户资源和产品经验, 完成传统封装基板向先进封装基板的转型, 投资 4 亿元新建了 m-SAP 制程生产线, 主要聚焦于 RF 射频类封装基板、SIP 封装、电源模块管理、光通讯等细分领域市场。2022 年第四季度, SIP 封装基板事业部一期产线成功通产, 二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产, 目前产能正在爬坡中。针对 m-SAP 线的产品, 普诺威正集中力量开发封装类半导体公司, 目前已经完成华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证, 并进入日月光半导体、诺思等供应商序列, 其他客户正在同步开发中。

#### **关于经营情况变化:**

根据 Prismark 报告, 2023 年封装基板市场整体下滑严重 (-28.2%), 主要是因为需求疲软、库存高企、价格侵蚀严重, 其整体需求于 2023 年上半年见底, 下半年逐步环比改善。随着 2024 年库存和需求改善, 以及与 2023 年低基数相比, 封装基板预计将成为

2024 年 PCB 市场增长最强劲的领域，增长率为 8.6%。

由于客户库存和需求持续改善，普诺威目前 IC 载板产品需求恢复速度加快，订单快速恢复、盈利能力持续改善。

珠海崇达三个工厂目前的情况详见下图：



附件清单（如有）